伟测科技 20260831

算力业务倍增驱动营收新高，折旧与稼动率波动短期承压毛利

摘要

- 2026Q2 营收 5.8 亿元，同比增 100%，环比增 22%创历史新高；净利润环比增 24%，预计 Q1 为全年业绩低点，后续呈环比增长趋势。
- 算力业务爆发式增长，营收占比由 2025H1 的 9%提升至 21.5%，绝对值增长 3-4 倍；国产算力客户覆盖度高，长期受益于国产算力扩产需求。
- 高端业务营收占比达 71%，但 Q2 毛利率环比下降 2pct 至 32.44%，主因折旧增加、人员成本上升及维修费计提，主营业务毛利基本持平。
- 资本开支维持高位，2026H1 投入 17 亿元（设备占 16.2 亿），预计全年折旧约 7.75 亿元；高端设备价值量占比超 70%，国产化替代主要集中在模拟机台。
- 业务结构调整，FT 占比升至 51%与 CP 持平，主因高端产品 CP 受限及 FT 拓展；FT 因人工与材料成本高，毛利率略低于 CP，对整体毛利产生一定压力。
- Q3 毛利率预期承压，主因消费电子旺季不旺、手机厂商下调销量预测导致产能利用率未达 2025 年同期水平，且新算力客户尚未大规模放量。
- 产能布局基本完成，无锡贡献超 50%营收；成都项目预计 2027 年开工，建成后国内布局成型，未来扩产将基于现有厂房进行。

Q&A

请介绍一下公司 2026 年上半年的整体经营业绩、业务结构变化以及资本支出情况？

2026 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.59 亿元，同比增长 57%；实现扣除非经常性损益后的净利润 1.46 亿元，同比增长 171%。营收超过 10 亿元，主要得益于国内算力和 AI 行业的增长。为应对市场需求，公司加大了固定资产投入，特别是三温测试和老化测试领域，推动了 Capex 的显著增长。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总资产达到 94.34 亿元，同比增长 57%；净资产为 42.28 亿元，同比增长 13%。资产规模的增长主要源于收入增长带来的利润增加，以及

2025 年发行的可转债于 2026 年上半年完成转股。 从单季度看，2026 年第一季度营收为 4.9 亿元，第二季度增至 5.8 亿元，同比增长 100%，环比增长约 22%，创下单季度营收历史新高。第二季度净利润环比增长约 24%。预计第一季度为全年业绩低点，后续将呈现环比增长趋势。经营性净现金流为 5.47 亿元，表现良好。 在业务结构方面，2026 年上半年 CP（晶圆测试）业务占比为 49%，FT（成品测试）业务占比为 51%，与以往 CP 占 60%、FT 占 40%的结构有所不同。这一变化主要是由于部分高端产品的 CP 业务受到影响，公司因此加大了 FT 业务的拓展力度。从产品层级看，高端业务营收占比持续提升，上半年达到 71%，中端业务占比为 29%。按客户类别划分，消费类业务占比约 59%，工业类占 25%，车规类占 15%左右，与 2025 年基本持平。从算力与非算力维度看，算力业务营收占比提升至 21.5%，非算力业务占 78.5%。与 2025 年上半年 9%的占比相比，算力业务的绝对值增长了三到四倍。 毛利率方面，第一季度综合毛利率为 34.96%，第二季度为 32.44%，下降了约两个百分点，主要受第二季度其他业务毛利率下降的拖累。主营业务的毛利率在两个季度间基本持平。同时，为支持产能扩张，折旧和人员成本同步上升，以及第二季度维修费用的增加，也对毛利率构成了一定压力。 费用方面，销售费用同比增长 42%，但费用率仍处于较低水平；管理费用和财务费用分别增长 21%和 16%，与营收增长基本同步。研发费用约为 9,000 万元，绝对金额有所增长，但随着多个项目进入量产阶段，其占营收的比例有所下降。 资本支出方面，2026 年上半年总投入为 17 亿元，其中设备投入为 16.2 亿元，显示了公司对后续市场，尤其是算力领域行情的看好。

公司目前的产能布局情况以及未来的扩产计划是怎样的？

公司目前主要有上海、无锡、南京、深圳四个生产基地。其中，无锡已成为最大的生产据点，贡献了超过 50%的营收，主要得益于大客户集中于此。上海和南京各占约 20%的份额，深圳占 4%，上海的微矽子公司占 3%。无锡的厂房已于 2025 年建成，目前正在积极部署产能并导入新客户。上海总部项目已封顶，预计 2026 年年底完成装修，2027 年开始陆续搬入，届时上海现有厂房的部分产能将迁移至新总部，为上海地区提供进一步的产能拓展空间。目前，公司在长三角和珠三角的产能布局已基本完成。未来，公司计划在西南地区进行布局，已规划在成都建设一个占地 60 亩的项目。该项目预计 2026 年内取得土地证和环评批复，2027 年开工建设。成都项目建成后，公司在国内的整体布局将基本成型，后续的扩产将主要在现有厂房基础上进行。

2026 年第三季度至今（7-8 月）算力与非算力业务的各自表现如何？以及对国产算力客户的展望？

大部分国产算力客户，包括近期上市的企业，基本都已成为公司的客户，部分已在进行实验或小批量量产，另一些则在接洽中。这些客户上市后，预计会谋求扩产和市场份额的提升，无论哪家算力客户取得发展，公司都将从中受益。公司有信心占据国产算力测试市场的主要份额，并长期受益于国产算力的整体增长。短期内，个别客户可能会因其自身发展节奏或产业链产能问题而产生一些波动，但

长期来看，算力业务的营收占比预计将持续提升。

对 2026 年第三季度的毛利率有何展望？主要的驱动因素是什么？

预计第三季度的毛利率表现可能比较一般。主要原因在于，七、八月份的整体产能利用率未及 2025 年同期水平。这部分受到了消费电子领域的影响，例如存储芯片涨价导致手机等产品的出货量下滑，进而影响了公司的相关业务。尽管第三季度通常是消费电子的传统旺季，但 2026 年多家手机厂商已下调了销量预测，对公司业务造成了一定影响。七、八月的产能利用率未能拉升至很高水平，这将直接影响毛利表现。此外，部分新的算力客户尚未开始大规模起量。相较于 2025 年第三季度毛利率达到全年高点，2026 年同期情况可能会有所变化，短期内存在一定压力，期望九月份或第四季度能出现转机。

2026 年上半年，智能驾驶业务的收入体量是多少？

公司未将智能驾驶业务从车规业务中单独拆分统计。

车规级芯片测试业务的收入规模及未来增长前景如何？

车规级芯片测试业务整体收入规模约为 1.6 亿元，该业务范畴包括智能驾驶（智驾）芯片测试以及车载 MCU 等其他汽车电子控制类芯片的测试。其中，智驾业务的收入规模达到数千万元级别，主要来源于一家成熟的既有客户，同时新增了一些其他智驾客户。展望未来，智驾领域的测试业务增长前景乐观。尽管现有主要客户可能因市场竞争及其他车厂自研芯片而面临一定影响，但市场上新增的智驾客户，包括部分车厂自研的智驾芯片，其测试业务也由我方承接。因此，无论市场份额如何分配，增量业务均会汇集于此，预计该领域将持续增长。

从长期来看，在算力芯片测试占比提升、CP 与 FT 业务结构变化，以及 SLT 和 Burn-in 等新业务引入的背景下，公司的毛利率趋势将如何演变？

公司的毛利率受到多方面因素的综合影响。首先，从业务结构看，目前 CP（晶圆测试）和 FT（成品测试）的业务占比基本持平，各占一半。由于 FT 业务的材料成本和人工成本（例如，一名员工在 CP 环节可看管 10-20 台机台，而在 FT 环节仅能看管 2-3 台）均高于 CP，而报价无法完全覆盖增加的成本，导致 FT 业务的毛利率低于 CP。因此，FT 业务占比的提升在一定程度上对整体毛利率构成了压力。其次，Burn-in（老化测试）和 SLT（系统级测试）等业务，其自身毛利率相对不高，主要作为 FT 业务的配套服务，旨在为客户提供全流程解决方案以增强客户粘性，并通过这些服务切入新客户的 FT 订单。虽然这些业务对绑定核心客户，尤其是在汽车电子和高性能计算芯片领域至关重要，但它们的增加也会轻微拉低整体毛利率。长期来看，提升毛利率的关键在于提高产能利用率，特别是高端设备的利用率。目前各设备平台的产能利用率存在差异，尚未达到市场景气时所有机台全面满载的水平，这对毛利率造成了波动。公司未来的发展策略

将聚焦于投入高端设备，并持续优化产品结构，以提升高毛利业务的占比。

公司 2026 年的折旧金额预计将达到怎样的量级？

根据目前的设备采购和转固节奏测算，2026 年上半年的总折旧额约为 3.1 亿余元，其中设备折旧约为 2.93 亿元。预计 2026 年全年的总折旧额约为 7.75 亿元，其中设备折旧预计约为 6.9 亿元。需要注意的是，该数据为当前预测，实际金额会根据设备采购和转固的实际进度动态变化，但总体上折旧成本将持续增长。

公司主要为哪些类型的客户提供 SLT 和 Burn-in 测试服务？以及这部分业务在资本开支中的占比情况如何？

SLT 和 Burn-in 服务主要配套给智能驾驶（智驾）客户、部分其他车载芯片客户（进行三温测试和老化测试）以及高性能计算（大芯片/算力芯片）客户。具体而言，智驾客户基本都需要进行 Burn-in 测试，而大部分算力芯片客户则需要集成的老化和 SLT 测试。在资本开支方面，投向 SLT 和 Burn-in 设备的金额占比不大。这类设备的单价约为两三百万元人民币，而高端 SoC 测试机的单价则超过一千万元人民币。因此，资本开支的大头仍然是 SoC 测试机。

在算力芯片测试业务中，CPU、GPU 和 SiC 各自的占比情况如何？CP 和 FT 的业务分布是怎样的？

公司未对算力芯片测试业务按 CPU、GPU、SiC 等具体产品类别进行拆分统计，业务量主要取决于客户产品的放量情况。在测试环节方面，CP 和 FT 业务均有覆盖。具体业务承接取决于芯片的代工厂：若芯片在台积电流片，公司无法承接其 CP 业务，会转而争取其 FT、Burn-in 和 SLT 业务；若芯片在国内 Fab 或其他晶圆厂（如三星）流片，公司则可以争取其 CP 业务。目前，公司在算力领域已承接了相当数量的 CP 和 FT 业务。

公司主要大客户上半年的收入占比是多少？目前公司的单月产值和年底预计达到的设计产能水平如何？

上半年，公司最大的客户收入占比约为百分之二十几到三十，该客户的业务主要在无锡厂区。当前，公司整体的单月产值约为 2 亿余元，目标是到 2026 年年底，单月设计产能能够达到 2.6 亿元左右的水平。

在算力芯片的测试程序开发方面，由公司自主提供的比例大概是多少？

目前没有对算力芯片测试程序中由公司自主开发的比例进行精确统计，但预计该比例不高。通常情况下，规模较大或自身研发能力较强的客户，会拥有自己的测试团队并主导测试程序的开发。不过，公司设在上海的子公司专门从事程序开发

业务，也为算力客户开发了相当数量的程序，但具体的占比数据尚未统计。

公司对 2026 年全年及未来几年的资本开支有何规划？

公司将继续维持较高的资本开支水平。2025 年，包含设备和土建的总投资额接近 30 亿元。2026 年下半年的资本开支节奏虽然略有放缓，但预计全年总额将与 2025 年大致持平。未来的投资计划将取决于整体市场状况和公司自身的资金情况。公司已公布一项 20 亿元可转债的发行计划，若募集资金到位，可能会进行更积极的投资。目前，资本开支主要通过银行贷款来支持。

Advantest 和泰瑞达等海外设备的当前交期是多久？公司的采购策略是什么，特别是在国产化替代方面有何考量？

目前，泰瑞达的设备交期尚可，但 Advantest 部分设备的交期有所延长，高端测试机可能需要七到九个月。这主要是由于存储芯片测试需求旺盛，Advantest 的产能优先向存储测试设备倾斜，导致其他 SOC 测试设备的产能减少，同时算力相关的测试需求也拉长了整体交期。 在采购策略上，公司采取分层布局：

1. 高端设备：坚持采购 Advantest 和泰瑞达的顶级测试设备，以满足高端客户的需求，并维持在国内第三方测试领域中高端设备保有量的领先地位。目前高端设备仍以进口为主，仅为特定客户采购了少量国产高端设备。
2. 中端设备：正在积极寻求国产替代方案，以应对中端 SOC 的测试需求。由于国内设备厂商竞争激烈，产品较多，公司目前仍在观察评估，以选择最具优势的供应商。
3. 探针台与分选机：探针台方面，由于国内尚无性能足够的产品，主要采购日本和韩国的设备。分选机方面，则同时采用台湾地区和国内金海通的产品，并且近年来持续加大了对以金海通为主的国产分选机的采购力度。

采购国产设备对公司的毛利率有何影响？

采购国产设备会使毛利率相对降低。国产设备厂商为了抢占进口设备的市场份额，通常会采取价格竞争策略，因此其设备价格和相应的测试服务毛利会低于采用最高端进口设备的服务。

公司目前测试设备的保有量、主要平台构成以及资产价值结构是怎样的？

公司目前设备保有量约为 1,500 台，规模较大。主流平台覆盖广泛，包括 Advantest 93K EXA、泰瑞达的 UltraFLEX、UltraFLEXplus 和 J750，以及台湾致茂电子、长川和华峰测控等国产机台。这种通用性强的机台布局有助于在单一客户订单波动时，灵活调配产能至其他客户，保证了业务的稳定性。从资产结构

来看，尽管中端机台在数量上占比较多，但高端机台的价值量占比已超过 70%。在国内第三方测试公司中，整体设备保有量，特别是高端设备的保有量，处于行业前列。

半年报中披露的 13 亿元在建工程测试设备，其采购到场和转固的周期是怎样的？

在建工程中的测试设备是一个动态滚动的过程。从设备采购到货，到完成布局、安装和调试，通常需要三至四个月的时间。因此，在每个报告期末，在建工程科目都会保有一定余额，其中既有新采购进入的设备，也有已完成调试转为固定资产的设备。例如，三季度报表中可能仍有十几亿的在建设备，但这包含了新购入和已转固的部分。

当前中端和高端测试服务的价格是否有变化，是否存在涨价的可能性？

目前测试服务的价格整体保持稳定，没有出现大幅上涨。虽然曾尝试对个别客户提价，但并未完全成功。测试业务的主要成本是设备折旧和人员薪酬，这些成本相对刚性，不像封装业务会因原材料价格上涨而传导至客户端。因此，测试服务涨价的难度较大，当前价格以稳定为主。

2026 年第二季度及上半年的高端与中端业务稼动率和收入占比情况如何？

从 2026 年上半年整体来看，高端业务的营收占比为 71%，中端业务占比为 29%。稼动率方面，第二季度整体稼动率约为 85%。不同业务的稼动率在季度间存在波动：第二季度高端业务稼动率有所回落，而中端业务表现相对较差；第一季度则是高端业务表现不佳，中端业务表现强劲。由于季度间的差异较大，建议以半年或全年的数据作为参考。

公司对未来 CP 和 FT 两块业务的收入占比有何展望？

历史上，公司业务结构为 CP 占 60%，FT 占 40%。但受 2025 年 BIS 政策等因素影响，CP 业务占比出现下降趋势。目前，CP 和 FT 业务的收入占比基本持平，各占 50%左右。从市场规模看，FT 的市场容量是 CP 的两到三倍。公司以 CP 业务起家，该业务是核心强项，未来不会放弃，并将持续开发新客户。同时，公司也会加大对高端 FT 业务的投入，以平衡市场变化和业务结构。长期来看，希望维持 CP 和 FT 业务各占一半的均衡比例。

为维持 CP 与 FT 业务规模的均衡，CP 业务需要保持与 FT 相近的增速，公司对此是否有信心？

公司在开发客户时，会同时争取 CP 和 FT 的订单，业务增速最终取决于市场需求。公司更倾向于承接 CP 业务，一方面因为在该领域有长期的技术积累和经验，另

一方面 CP 与 FT 的业务复杂性不同。因此，公司会继续努力争取 CP 业务订单，不会放松在该领域的投入。

在产能协调方面，测试机是否可以在 CP 与 FT 业务之间，以及在算力与消费电子业务之间进行灵活调配？

可以进行协调。CP 和 FT 业务使用的是相同的测试机，区别在于 CP 业务需要一台测试机搭配一台探针台，而 FT 业务则是一台测试机搭配一台分选机。因此，同一台测试设备可以通过更换配套的探针台或分选机，在不同业务类型之间实现产能的灵活调配。

在 CP（晶圆测试）和 FT（成品测试）业务中，测试机台是否可以通用？公司如何调整不同产品线之间的产能，例如将消费电子的产能调配至算力芯片测试？

CP 和 FT 业务所使用的测试机是相同的，通过配置不同的探针台或分选机即可实现切换。从内部设备数量来看，探针台与分选机的合计数量大于测试机台的总量，这为公司在 CP 和 FT 业务之间进行灵活的产能调配提供了基础。此外，相同型号的设备也可以在不同产品线之间进行调整。例如，用于消费电子和算力芯片测试的 Advantest 93K 机台可以相互转换，尽管这可能需要根据不同产品的测试需求增减板卡，并耗费一定的改机时间，但整体上不存在重大障碍。目前，公司已经开始根据产能调配的需求，将部分消费电子的产能转移至算力芯片测试业务。这一过程中，由于不同芯片的测试侧重点和功能各异，设备配置也需要相应调整，有时公司会通过租赁或购买新的板卡来完成设备改造。

与采购海外设备（如 Advantest 93K、Teradyne）相比，采购国产测试机台是否会导致毛利率相对较低？其背后的原因是什么？

从实际运营情况来看，使用国产机台的业务毛利率相对会略低一些。这主要是因为国产设备虽然采购价格较低，但其对应的测试服务价格也相应较低。值得注意的是，高端国产设备的价格与海外设备相比，并未形成显著的成本优势。其研发成本高昂，且部分关键零部件（如主芯片）可能仍需进口，导致其整体成本并未如市场预期的那样低。此外，在某些配套设备领域，例如探针台，目前尚未实现国产化，公司使用的均为日本或中国台湾的产品。尽管曾与国内供应商接触，但其产品成本甚至高于公司当前的采购价格，缺乏经济性。

在公司现有的约 1,500 台设备中，国产设备的占比情况如何？

国产设备的占比需要根据设备类型进行区分。在模拟芯片测试机台方面，目前已基本实现全面国产化，主要采用华峰测控等公司的设备。而在数字和数模混合测试机台领域，国产设备的渗透率仍然较低，占比不足 10%。

第二季度毛利率下降的主要原因是什么？是否与算力芯片业务占比提升有关，因为该业务可能更多使用毛利率相对较低的国产设备？

第二季度毛利率下降并非由产品结构变化（如算力业务占比增加）导致。其主要原因在于成本端的上升和稼动率未能进一步提升。成本增加具体体现在几个方面：首先是新增设备转为固定资产后开始计提折旧；其次是人员数量的增加；最后还包括一部分维修费用的计提。因此，毛利率的波动主要是由整体成本上升所驱动的。

公司人员数量在年度内的变化趋势是怎样的？人员成本通常在何时体现？

公司的人员部署具有前瞻性，通常会为业务旺季提前进行招聘。例如，针对第三、四季度的旺季，公司会提前两到三个月开始增加人员储备，以进行必要的培训。特别是对于一些重要客户，需要配备专人服务，相关的人员成本会提前体现在财务报表中。因此，公司的人员数量在年底时达到峰值，以应对春节期间可能出现的一批员工离职。春节后，随着部分员工的自然流失，第一季度的人员数量会相对较少，随后在第二、三季度逐步回升，呈现出这样的周期性趋势。

人在草木间